

Venus 6系列

面板级先进封装量检测设备

Panel-Level Advanced Packaging Inspection & Metrology System



应用范围 Application Scope

检测类型

TGV/TSV、RDL、激光盲孔等先进封装工艺量检测

样片尺寸

8~12寸晶圆, 510×515~730×920 mm²玻璃基板

设备特点及优势 Product Introduction

兼容性强

玻璃基板、TGV/TSV
通孔、激光盲孔、
RDL等多种类型

多种通道

明场(R/G/B)、透射
及暗场多通道同步
成像

彩色复检

同倍彩色复检同步
存图或高倍彩色复
检, 兼顾高检测通
量与正检率

功能强大

表面/腰孔多焦面同
步成像, 暗场照明角
度自动切换, 输出各
类直观分布图等

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

软件算法 Software Algorithm

- ◆ 数据可视化: 输出各类缺陷分布图, 和各关键尺寸的热力分布图与统计分析图表, 直观呈现工艺质量
- ◆ 全流程追溯: 支持各工艺后同片测量结果同位分析, 可量化分析各工艺对缺陷的影响, 助力工艺优化
- ◆ 先进算法支撑: 搭载 Die to Database、Die to Golden Die 算法, 融合深度学习自动检测, 适配复杂工艺需求
- ◆ 实时自动聚焦: 搭配 5×、7.5×、10×、20×、50× 多种光学放大倍率, 确保量检测更精准

性能参数 Performance Parameters

检测对象	量测参数	缺陷检测类型
TGV/TSV通孔	上孔/腰孔/底孔: 孔径、圆度、孔位置偏移; 孔同心度	多孔、漏孔、盲孔、孔径异常、玻璃气泡、异物、微裂纹、脏污、划痕等
激光盲孔	圆度、开口率、位置偏移、孔同心度	漏孔、残留等
再布线层 (RDL)	线宽、线距	凹陷、脱落、异色、Open / Short、残留、残金、划伤等

检测图例 Inspected Defects

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号